区分	□樹脂成形　■電子部品　□鍛造・鋳造　□プレス加工　□表面処理 □機械加工　□金型・治工具　□自動機・装置　□システム・ソフトウェア □素材　□その他（　　）

展示No.	提案名	工法	新規性
10	少量、多品種半導体ICのカスタム製品開発	LSIの設計	日本初

セールスポイント

【100品種以上のLSI開発実績】
・大手半導体メーカーが終息する、EOL(製造終息)のリメイク開発を実現
・永年供給出来るカスタムマイコンの開発～製造。ルネサス社IPのご提供で、互換開発を実現
・現存するICの解析や、新規LSIの設計受託等、半導体に関する要望にお答えいたします

提案技術・提案工法

汎用の半導体製品　　**弊社製カスタムIC**

＜課題・ニーズ＞
・大手半導体メーカーでは、大量生産を前提として生産している為、少量製品はEOL(製造終息)になりやすい
・半導体が１個でも入手難となれば、制御基板、最終製品の生産が出来なくなる

弊社で、カスタムIC化することにより、少量、多品種製品でも永年供給を実現します

㈱ロジック・リサーチでの取り組み
・弊社は、ファブレスの半導体メーカーで、LSI設計～テスト開発まで熟練した技術で所望の半導体ICをご提供します。
・カスタムマイコンは、ルネサス社のIPを活用し、設計～、試作、量産品をご提供可能
・製造委託先様との協力関係構築により、生産面も安定供給を実現します

製造委託先例
tsmc　VIS 世界先進　UMC　越豐電子股份有限公司 GREATEK ELECTRONICS INC.　DENKEN　東洋電子工業株式会社　内藤電誠グループ　STK STK TECHNOLOGY CO.,LTD.　SFA SEMICON　株式会社日出ハイテック

・その他対応実績：FPGA設計、設計請負、
基板解析、IC解析、ﾊﾟｯｹｰｼﾞ開発、ﾊﾟｯｹｰｼﾞ請負、ﾃｽﾄ開発、不良解析

適用可能な製品/分野	製造可能な精度／材質等
・供給が困難な、少量、多品種の半導体IC	・半導体製造においてレガシープロセスの製造が必要で0.35um、0.5umのプロセス等で設計を行います

問題点（課題）と対応方法	開発進度　（　　年　　月　現在）
・問題点：少量の汎用半導体製品は、(EOL)製造終息が多発する。 ・対策：弊社の独自の開発手法で、製品をカスタム化し永年供給を実現します。	□ アイデア段階　■ 試作/実験段階 □ 開発完了段階　□ 製品化完了段階
	パテントの有無 □ 有　（　　）　■ 無

提案の狙い/従来との比較（数値割合）

□ 原価低減	（　　）	□ 品質/性能向上	（　　）
□ 質量低減	（　　）	□ 安全/環境対策	（　　）
■ 生産（作業）性向上	（　　）	□ その他（　　）	（　　）

会社名	所在地
株式会社ロジック・リサーチ	福岡県福岡市早良区百道浜3-8-33 福岡システムLSI総合開発センター 310号室
連絡先	URL　：http://www.logic-research.co.jp
部署名：営業部	Tel No.：092-834-8441
担当名：村嶋　義秀	E-mail：info@logic-research.co.jp
主要取引先	海外対応
コニカミノルタ㈱ パナソニック㈱	■ 可（生産拠点国を記入）台湾、中国、韓国　□ 否